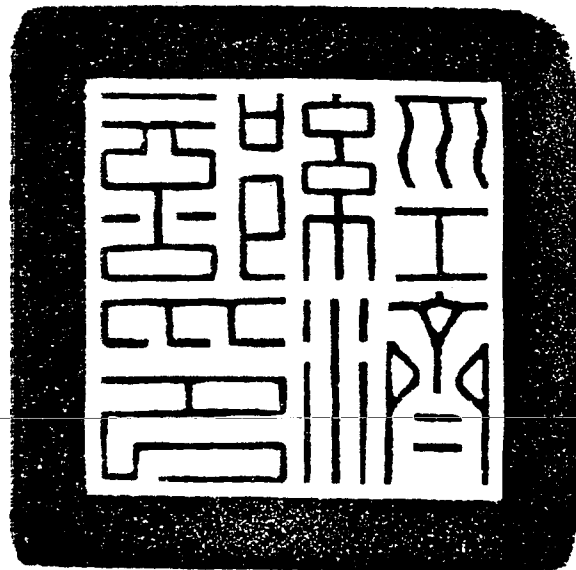


經濟部 公告

發文日期：中華民國115年2月23日
發文字號：經授產字第11551004430號
附件：公告事項



主旨：公告本部「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「臺荷創新研發合作補助計畫」公告事項，自公告之日起正式受理申請。

依據：經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法。

公告事項：「臺荷創新研發合作補助計畫」公告事項詳如附件。

部長 龔明鑫

本案授權產業發展署決行

裝

訂

線

「臺荷創新研發合作補助計畫」公告事項

一、計畫目標

依據《產業創新條例》，政府得推動跨國技術合作計畫，促進產業升級與創新發展。為強化臺荷雙方產業研發合作，擴大國際技術鏈結與創新能量，特訂定本合作計畫。

二、補助資格條件

本計畫可由單一企業或多家企業聯合提出申請，如為2家以上之聯合提案，須由其中一家企業擔任主導單位提出申請，申請資格為：

- (一)國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司。
- (二)非屬銀行拒絕往來戶，且淨值(股東權益)為正值。
- (三)不得為陸資投資企業(依經濟部投資審議司公布之最新陸資來臺投資事業名錄)。

三、申請時程

自公告日起至115年6月2日止，應於公告受理期間親送或郵寄計畫書(郵寄日期以郵戳為憑；親送須於公告截止日當日下午5時前送達)。

四、重點補助領域

本次徵件邀請臺灣與荷蘭之企業研發合作聯盟針對「整合光子學(矽光子, Integrated Photonics)」領域提出高品質研發專案。計畫目的在於支持整合光子領域的前瞻研究與創新合作，並支援能實現未來大規模量產的賦能技術(Enabling Technologies)。專案內容可包含但不限於以下與光子整合電路(Photonic Integrated Circuit, PIC)相關之技術：

- (一)先進材料的異質整合(Heterogeneous Integration):例如 III-V 族半導體、矽(Si)、氮化矽(Si₃N₄)、鈮酸鋰(LiNbO₃)及氧化鋁(Al₂O₃)等。
- (二)應用於進階領域的可插拔模組(Pluggable Module)與/或共同封裝光學(Co-Packaged Optics, CPO)。

- (三)先進光子封裝(Advanced Photonic Packaging)、量測(Metrology)與測試技術(Testing Techniques)。
- (四)利用整合光子學(矽光子)開發的新型感測技術(Sensing Technologies)。

五、計畫期程

- (一)計畫開始日以 116 年 1 月 1 日或其後起算。
- (二)計畫時程以不超過 3 年為原則。

六、計畫應附文件-雙方合作證明文件

- (一)臺荷共同提案書(Common Proposal)。
- (二)雙方廠商聯盟協議書(Consortium Agreement)，須含智財權分享與規劃(核定通過簽約時檢附)。

七、其他(相關注意事項)

- (一)本計畫以業者合作為核心，鼓勵臺荷雙方業者共同議定研究主題，各自向雙方政府提出申請補助。
- (二)同一企業或同一代表人於同一時期申請及執行之「產業升級創新平台輔導計畫」相關計畫總件數，以不超過 3 件為原則。
- (三)計畫提案經費規模，臺方計畫經費應至少占臺荷總計畫經費 30%，不可超過 70%(依計畫需要合理編列)。
- (四)收件後臺荷雙方進行獨立審查並交互比對結果，在雙方均通過審查時，始予以補助。補助比例以臺方計畫總經費 50%為上限，其餘部分由申請單位自籌。
- (五)依據比對結果，提報本部核定，確認計畫審查結果並核定補助款金額及比例。

八、諮詢專線

經濟部產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」
林先生 02-2704-4844#150 (kaitolin@smecf.org.tw)